

# CA-IS3115AW 隔离电源

## 测试板说明

### 描述

此份文件描述了 CA-IS3115AW 测试板的相关使用说明，其中有产品介绍、原理图、PCB 布线图、物料清单以及部分测试数据等。CA-IS3115AW 评估版可以用来简单评估 CA-IS3115AW 内置的隔离电源以及数字隔离的参数性能等。

### 芯片简介

CA-IS3115AW 是一款支持  $5kV_{RMS}$  隔离耐压的 DC-DC 转换器芯片，集成片上变压器，能够高效率传输大于 1.5W 功率到副边。该芯片采用特有控制架构，能够快速响应负载变化，并且精确调节输出电压。CA-IS3115AW 的出现可替代传统分立器件组建的隔离电源方案。该方案物理尺寸更小，且能够实现完全隔离。

CA-IS3115AW 集成软启动、短路保护、过温保护等多种保护功能以更好地增强系统的可靠性。CA-IS3115AW 具有 EN 使能管脚，当 EN 为低电时，输出电压为零，此时电源仅有微安级待机输入电流。

可通过管脚 SEL 选择 4 种输出电压，分别为 5V、3.3V、5.4V、3.7V，支持输出端接 LDO，以方便用户不同的电压需求。CA-IS3115AW 器件采用 16 脚宽体 SOIC 封装，绝缘耐压高达  $5kV_{RMS}$ 。

### 测试板 3D 仿真图

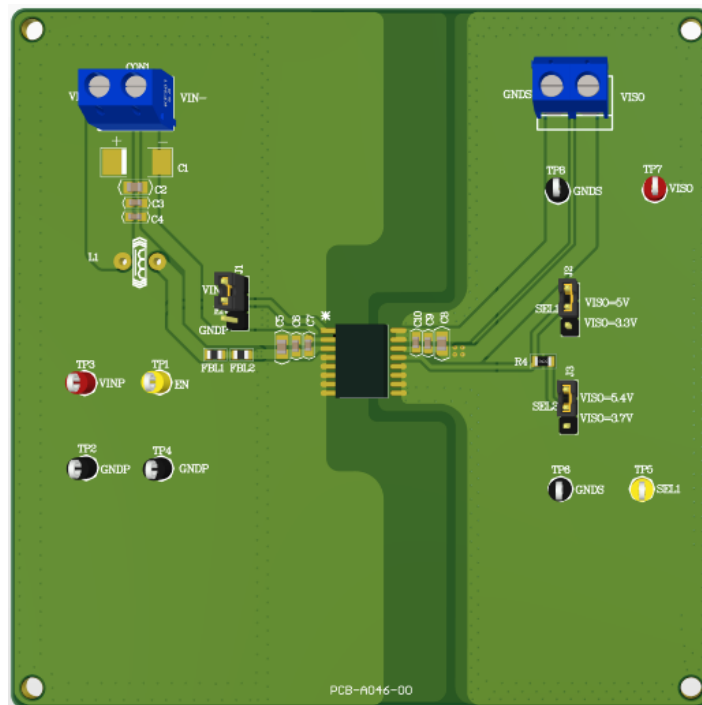
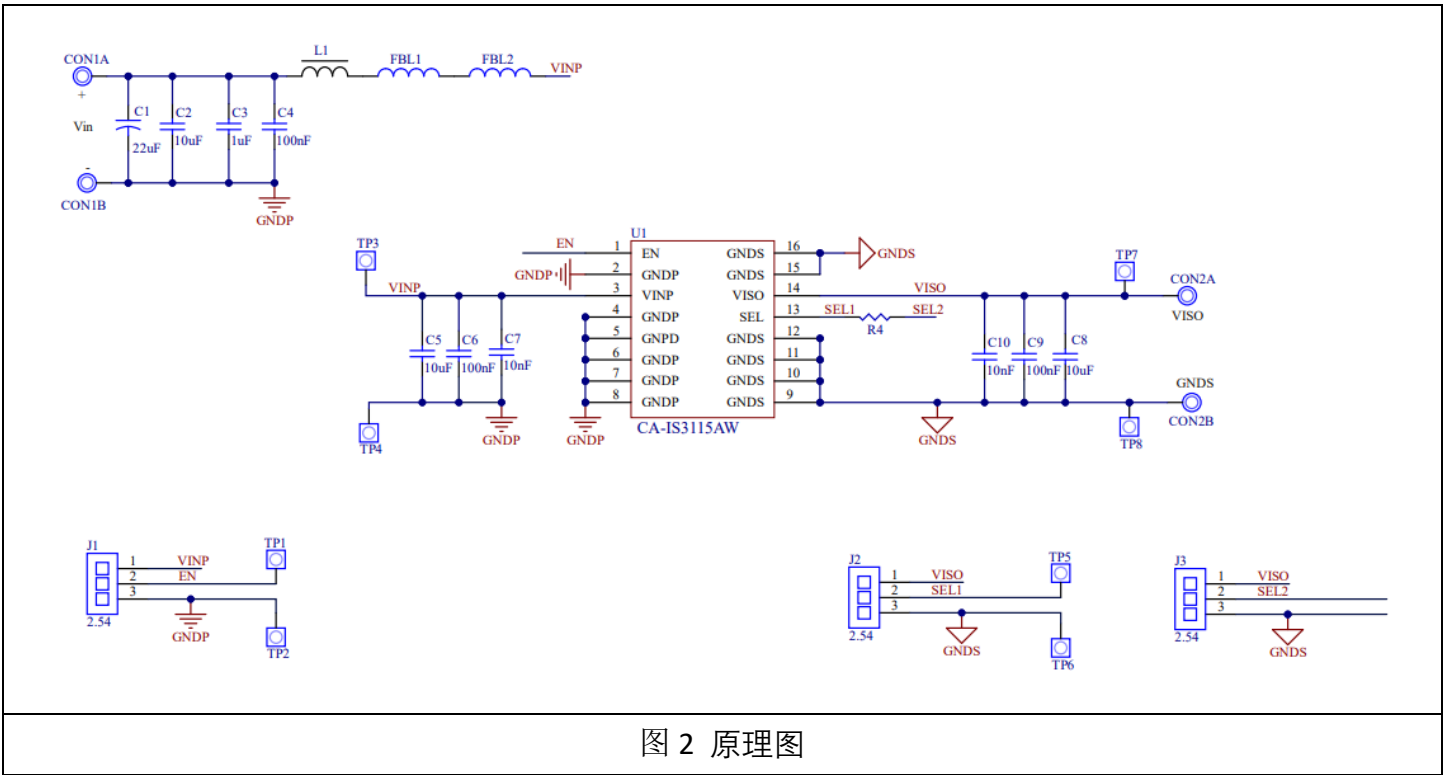


图 1 CA-IS3115AW PCB 的 3D 仿真图

原理图



布线图

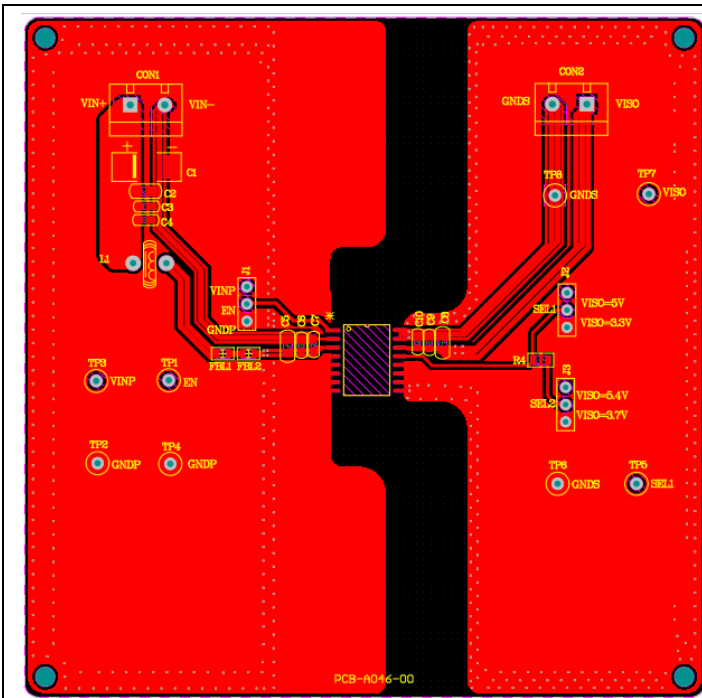


图 3 TOP

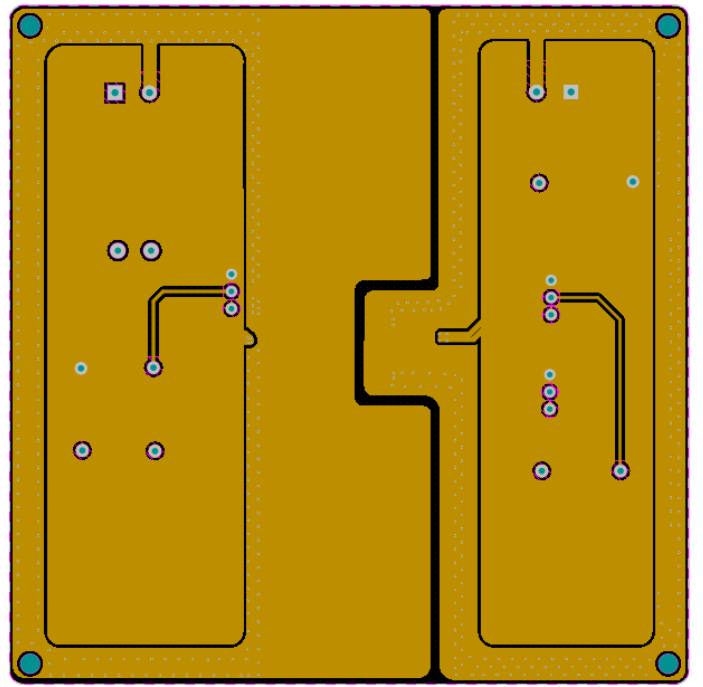


图 4 Inner Layer1

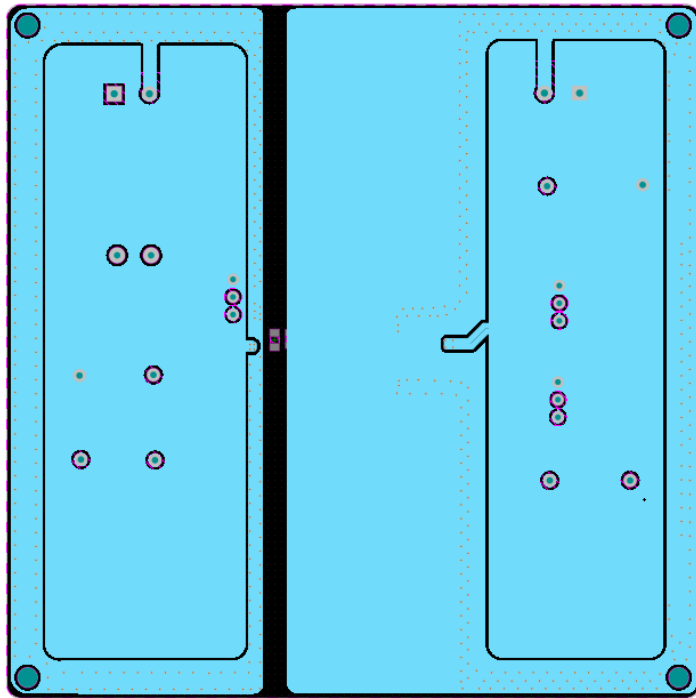


图 5 Inner Layer2

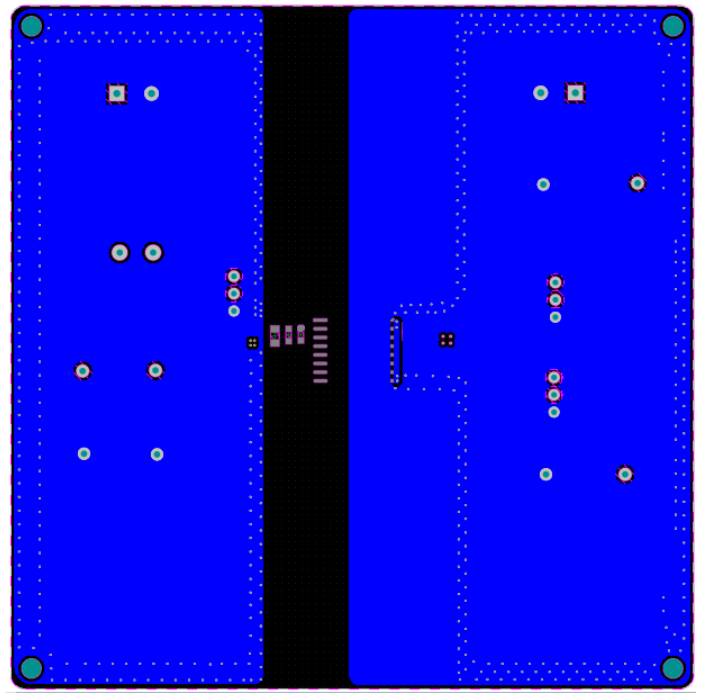


图 6 Bottom

**物料清单**

Item	Ref Des	Qty	Description	Package	MFR	PN.
1	T1,T2	2	CONN Banana Jack Solder	-	Keystone	575-4
2	FBL1,FBL2	2	Beed 600Ω	0805	Linekey	FBG2912-601Y
3	C1	1	Tantalum cap,22uF	7343	AVX	TAJD226K025RNJ
4	C2,C5,C8	3	MLCC, 10μF/10V, X7R	0805	-	Standard
5	C3	1	MLCC, 1μF /10V, X7R	0603	-	Standard
6	C4, C6, C10	3	MLCC , 100nF/10V, X7R	0603	-	Standard
7	C7,C14	2	MLCC, 10nF/10V, X7R	0603	-	Standard
9	U1	1	CA-IS3115AW	SOP16WB	Chipanalog	CA-IS3115AW
10	L1	1	24uH, 0.7mm, 4.5mm*12mm	-	Wurth Elektronik	7447043
11	TP3,TP7	2	Test Point, Red, Through Hole, 1mm	-	Keystone	5000
12	TP1,TP5	2	Test Point, Yellow, Through Hole, 1mm	-	Keystone	5009
13	TP2,TP4,TP6,TP8	4	Test Point, Black, Through Hole, 1mm	-	Keystone	5001
14	J1,J2,J3	3	Header, 3 pin, 2.54mm	-	-	Standard

测试仪器

直流电源、500MHz 带宽示波器安捷伦 DSOX3054T、6.5 位多功能万用表安捷伦 34465A、高频信号发生器等。

硬件连接

1. 将直流电压源连接到 T1 和 T2;
2. 将 EN 置高电平，通过跳线帽将 SEL1/SEL2 分别置高或者置低电平，选择不同的输出电压;
3. 通过示波器或者万用表测量输出电压。

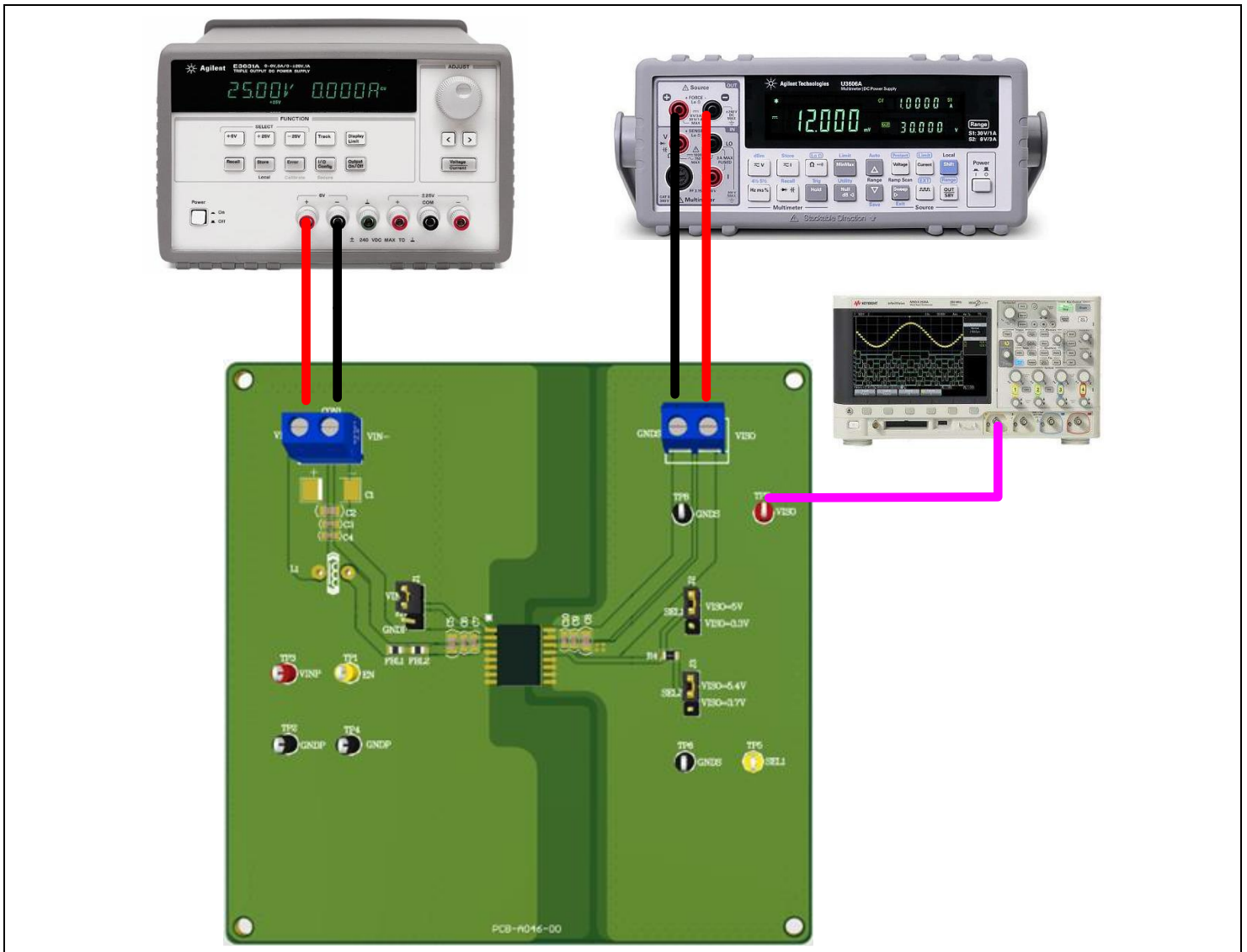


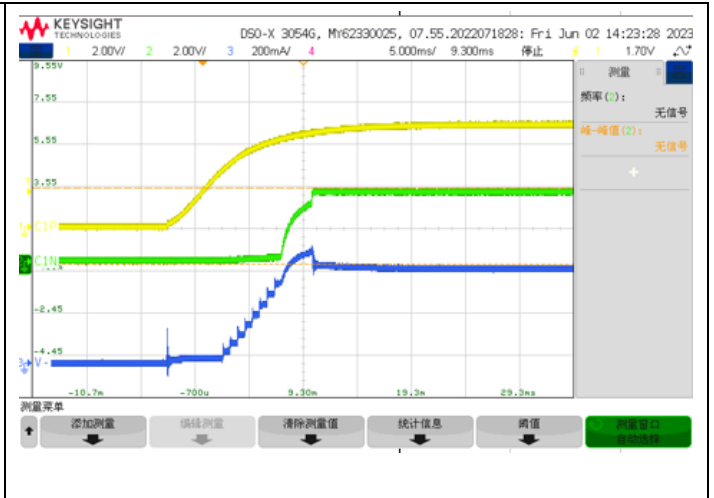
图 7 硬件连接图

测试示例

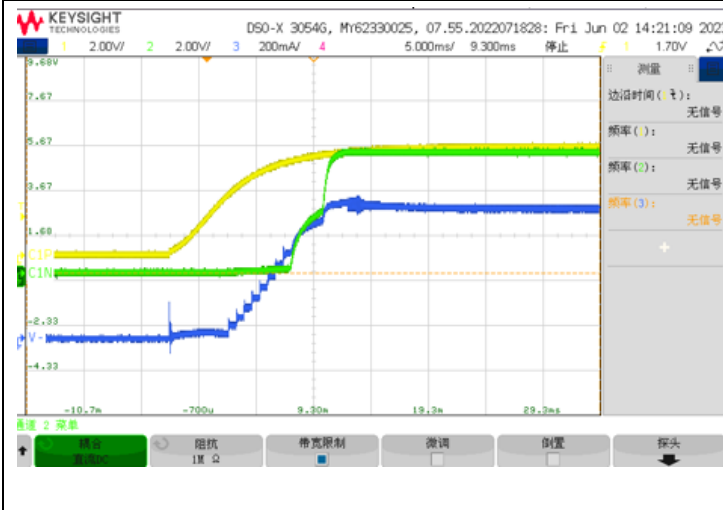
下面是 CA-IS3115AW 测试的典型波形，包括启动波形、输出纹波、输出动态响应、负载调整率、效率等。



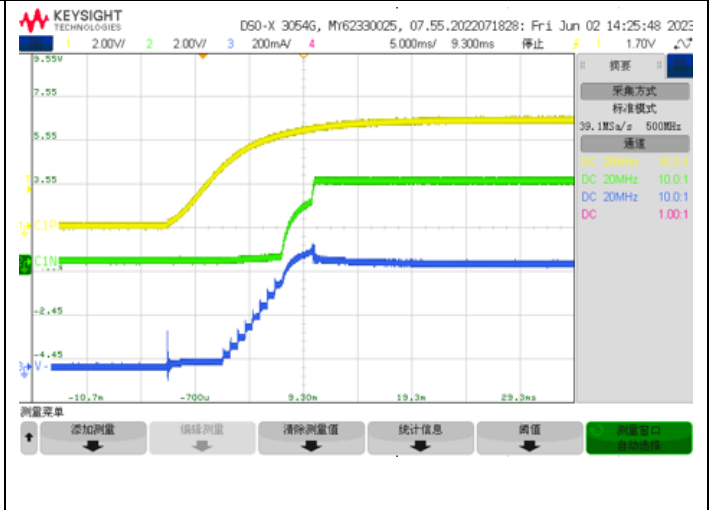
VINP =5V(黄色), VISO=5V(绿色), 软启动波形, IISO=300mA(蓝色)



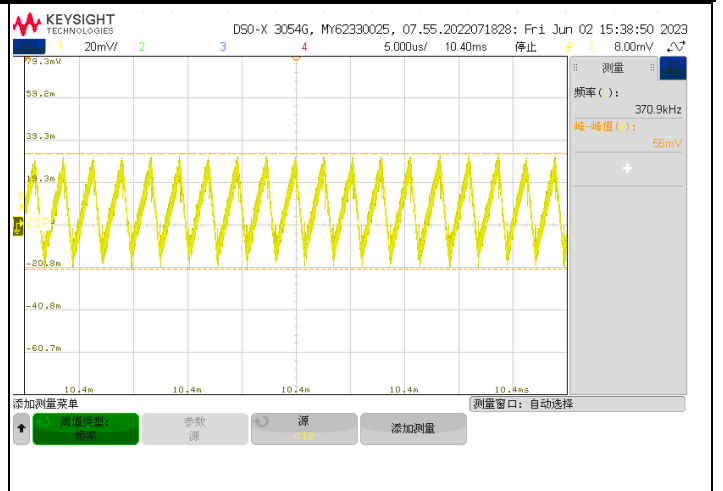
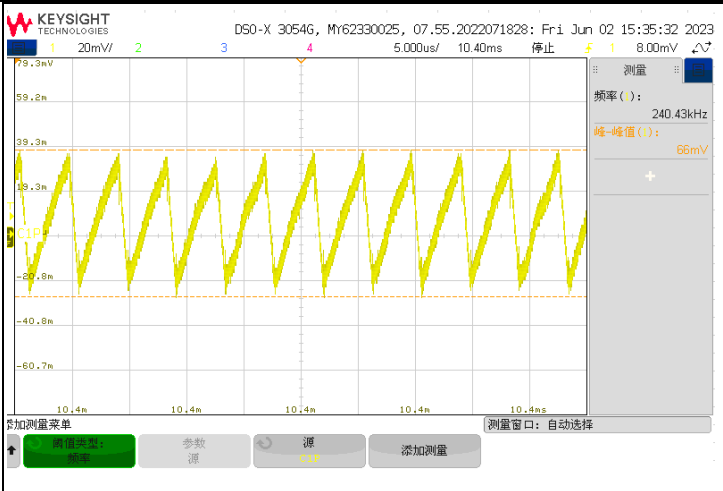
VINP =5V(黄色), VISO=3.3V(绿色), 软启动波形, IISO=300mA(蓝色)



VINP =5V(黄色), VISO=5.4V(绿色), 软启动波形, IISO=300mA(蓝色)

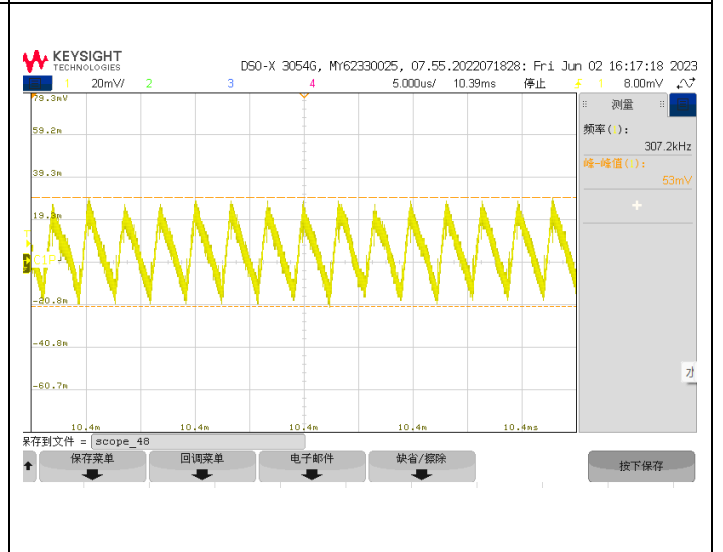
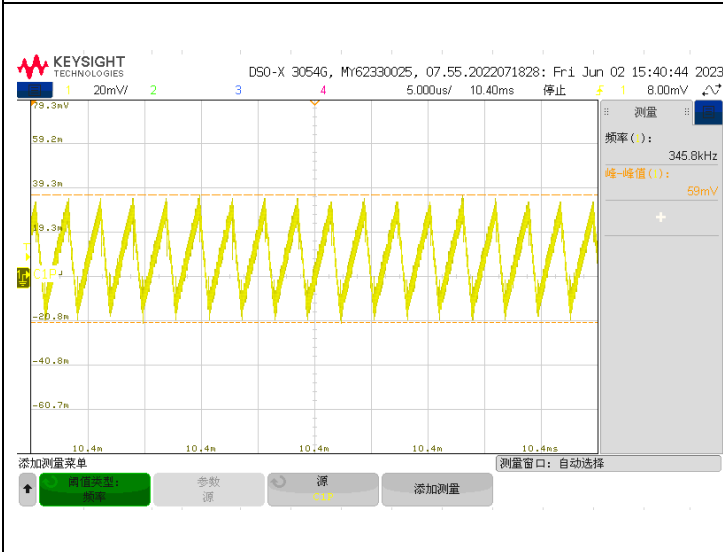


VINP =5V(黄色), VISO=3.7V(绿色), 软启动波形, IISO=300mA(蓝色)



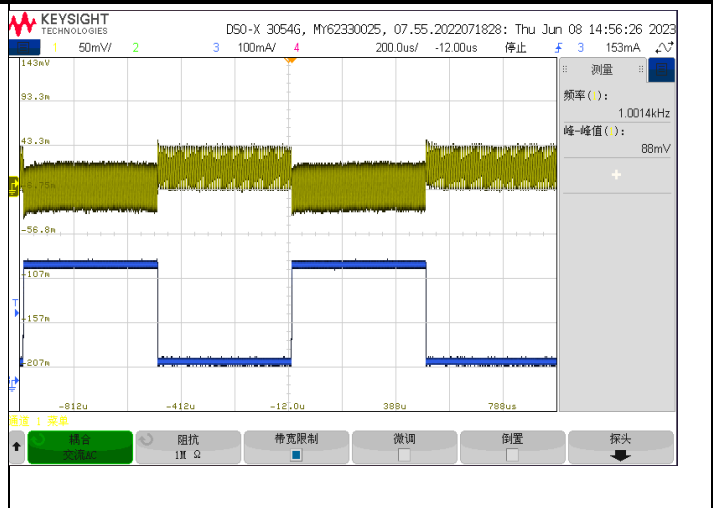
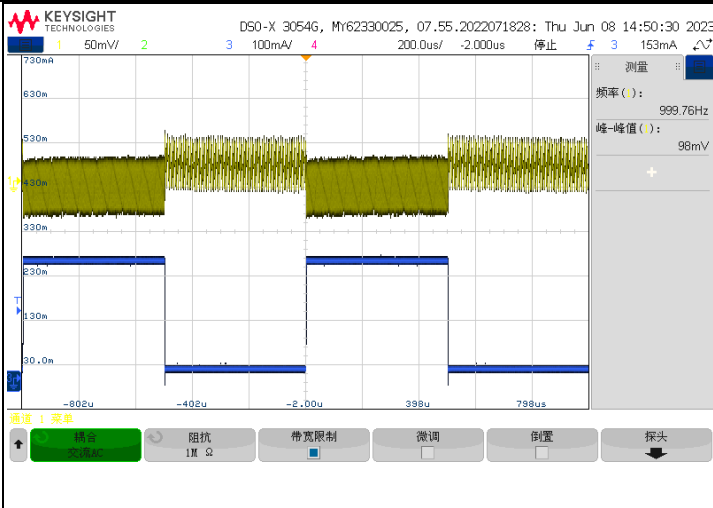
VINP =5V, V<sub>ISO</sub>=5V, I<sub>ISO</sub>=300mA, V<sub>ISO</sub> 纹波电压峰峰值

VINP =5V, V<sub>ISO</sub>=3.3V, I<sub>ISO</sub>=300mA, V<sub>ISO</sub> 纹波电压峰峰值



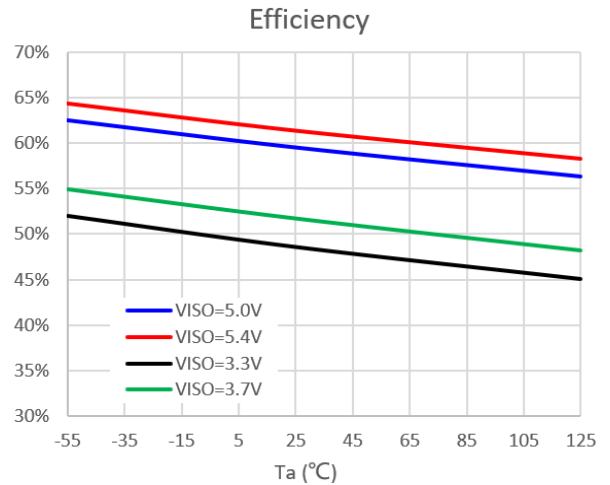
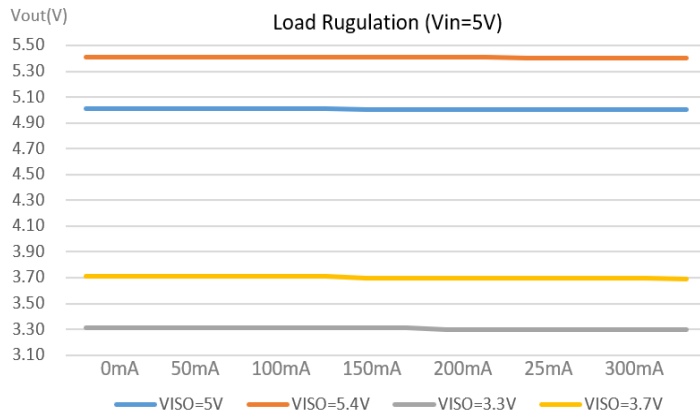
VINP=5V, V<sub>ISO</sub>=5.4V, I<sub>ISO</sub>=300mA, V<sub>ISO</sub> 纹波电压峰峰值

VINP=5V, V<sub>ISO</sub>=3.7V, I<sub>ISO</sub>=300mA, V<sub>ISO</sub> 纹波电压峰峰值



VINP =5V, VISO=5V, 动态负载电流: 30mA/270mA

VINP =5V, VISO=3.3V, 动态负载电流: 30mA/270mA



VINP =5V, VISO=5V/5.4V/3.3V/3.7V, 输出电流 0mA-300mA

VINP =5V, VISO=5V/5.4V/3.3V/3.7V, 输出电流 300mA



## PCB 布线建议

- CA-IS3115AW 内置开关电源，为副边侧和外部模块提供稳压电源。输入侧VINP和输出侧VISO的旁路电容和供电电容的位置放尽可能摆放在靠近芯片的管脚，距离应控制在2mm以内，如下图17和图18所示。当需要在供电电源线和地线中放置过孔，应放置在电容相对于芯片管脚的外侧，而非放置在电容和芯片之间，以减少过孔寄生电感的影响，如下图19和图20所示。

图17 推荐	图18 不推荐	图19 推荐	图20 不推荐

- CA-IS3115AW 集成隔离开关电源，存在一定的传导噪声和辐射噪声。适当的PCB拼接电容，对改善传导干扰和辐射干扰有一定的作用。如在PCB原边GNDA和副边GNDB之间的拼接电容以及VINP/VISO对GNDA/GNDB的拼接电容，如下图21，图22。此外，在PCB边缘处放置一系列间隔距离不大于3mm至4mm的地过孔，形成边缘防护，如下图23所示。

图21 原边GNDA和副边GNDB的拼接电容	图22 VINP/VISO对GNDA/GNDB的拼接电容	图23 VINP层四周用地平面包围，地平面外侧放置一系列间距小于4mm的过孔

## Revision History

版本	日期	状态描述
Ver1.0	Jan.2024	初始版本

## 重要声明

上述资料仅供参考使用，用于协助 Chipanalogue 客户进行设计与研发。Chipanalogue 有权在不事先通知的情况下，保留因技术革新而改变上述资料的权利。

<http://www.chipanalogue.com>